

Lin / Ryan / Wu

## Materials, Processes, Integration and Reliability in Advanced Interconnects for Micro- And Nanoelectronics

Volume 990: Symposium Held April 10 12, 20

---

 fachmedien.de  
WISSEN. EINFACH. FINDEN.

**41,10 €**

38,41 € (zzgl. MwSt.)

*Lieferfrist: bis zu 10 Tage*

---

**Artikelnummer:** 9781107408715

**Medium:** Buch

**ISBN:** 978-1-107-40871-5

**Verlag:** Cambridge University Press

**Erscheinungstermin:** 26.07.2012

**Sprache(n):** Englisch

**Auflage:** Erscheinungsjahr 2012

**Produktform:** Kartoniert

**Gewicht:** 519 g

**Seiten:** 358

**Format (B x H):** 152 x 229 mm

 fachmedien.de  
WISSEN. EINFACH. FINDEN.

**Kundenservice Fachmedien Otto Schmidt**

Neumannstraße 10, 40235 Düsseldorf | [kundenservice@fachmedien.de](mailto:kundenservice@fachmedien.de) | 0800 000-1637 (Inland)

08.08.2024 | 14:17 Uhr

